

21850-130 MTCA.4 RTM FILLER-MODUL MIT LUFTLEITBLECH, MID-SIZE DOUBLE, FÜR RTM BACKPLANE



PRODUKTbeschreibung

Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Zur Abdeckung ungenutzter Slots innerhalb eines MicroTCA.1- oder MicroTCA.4-Systems

Flansche mit unverlierbaren M3-Schrauben zur Befestigung am Kartenkäfig

EMV geschirmt

PRODUKTmerkmale

Produkttyp: Systemmodul

Produktfamilie: MicroTCA

Typ: Filler-Modul

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDetaiLS

Zur Abdeckung ungenutzter AdvancedMC-, MCH- oder PM-Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen oder ungenutzter Slots in einem MTCA.0-System mit Anschraubleiste. Die Module bestehen aus einer Frontplatte mit Flansch und unverlierbaren Schrauben, einer EMV-Dichtung und einer Seitenwand. Die Module können mit den unverlierbaren Schrauben am Kartenkorb befestigt werden.



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER